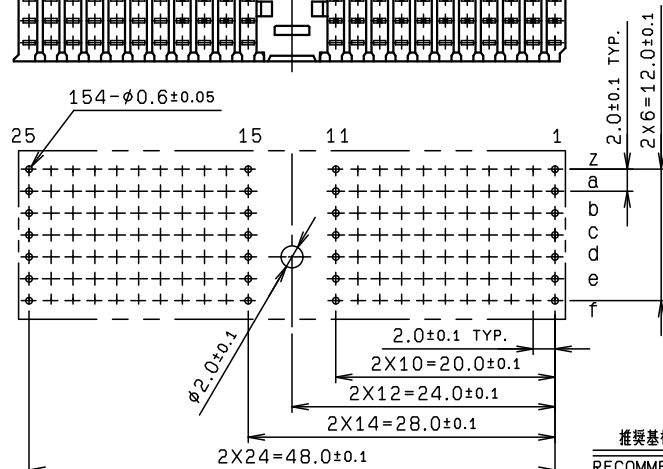
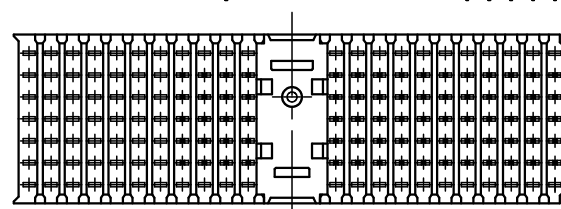
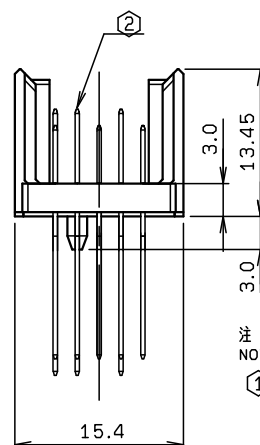
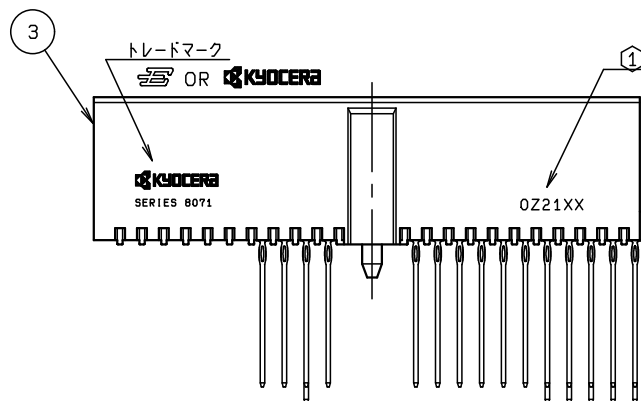
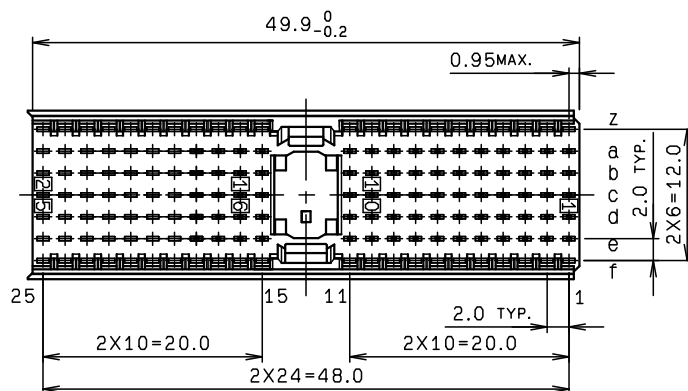




推奨基板取付け寸法（部品面）

NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	MATERIAL	DRW NO.	REMARKS
1	PLUG CONTACT(LEVEL-M)		65	PHOS-BRONZE	AJS 8071501	
2	PLUG CONTACT(LEVEL-P)		10	PHOS-BRONZE	AJS 8071501	
3	PLUG INSULATOR		1	PBT (GF30%)		UL94V-0 COLOR : GRAY

型番 _____ P/N _____

接頭 _____ 17 8071 075 048 XXX

PREFIX
17: プラグ
PLUG
プレスフィットタイプ
PRESS FIT TYPE

極数 _____

NO OF POS.
075: 5X15=75P

バリエーション _____

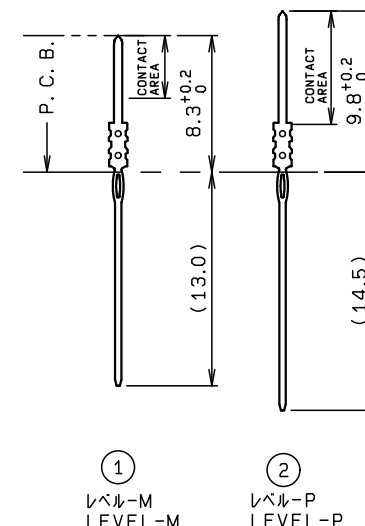
VARIATION
048: ストレート, ボラキー付き
コンタクト配列: カスタム
ST. WITH P.K.
CONTACT LAYOUT: CUSTOM

めっきコード _____

PLATING CODE

めっきコード PLATING CODE No.	下地のめっき UNDER COAT	接点部のめっき CONTACT AREA	プレスフィット部 PRESS FIT AREA
518	Ni: 1.2~3.0μm	Au: 0.1μm MIN.	Au 0.05μmMIN.
519		Au: 0.38μm MIN.	
515		Pd/Ni: 0.65μm MIN. Au: 0.1μm MIN.	
517		Au: 0.76μm MIN.	

suffix _____



CONTACT DETAIL

注 記
NOTE

① 製造ロット番号表示 LOT NO.
0Z21XX
製造年 YEAR 製造ラインコード LINE CODE
製造月 MONTH 製造日付 DATE

② ピン配置 (コネクタ嵌合面側)
CONTACTS LAYOUT
(CONNECTOR MATING SIDE SHOWN)

3. 適用基板仕様 APPLICABLE P. C. BOARD
基板厚 P. C. BOARD THICKNESS : $t=1.4\sim 4.2\text{mm}$

穴径仕様 APPLICABLE T/H
下穴径 PREPARED HOLE DIA. : $\phi 0.7 \pm 0.025\text{mm}$
銅めっき厚 COPPER PLATING THICKNESS: $25\sim 50\mu\text{m}$
(はんだめっき厚 SOLDER PLATING: $4\sim 10\mu\text{m}$)
仕上り径 FINAL PLATED HOLE DIA. : $\phi 0.6 \pm 0.05\text{mm}$

RoHS規制対応
COMPLIANT WITH
RoHS REGULATIONS

TOLERANCE / 一般公差 (S)		PRODUCT SPEC / 製品規格									
X <10 ±0.2 10≤ X <30 ±0.25 30≤ X ±0.3		201-03-376		A	DCN19884	2019/08/30	R. ARAI	H. TAMAI	M. YOSHIDA		
		UNIT mm		ANGLE 3RD		O	EDN-790	2004/07/14	M. YOSHIDA	Y. SHIROYAMA	H. TAGUCHI
		SCALE 2 : 1		DATE 2004/07/14		NO.	EDN/DCN	DATE	ISSUE	CHECKED	APPROVED
ANGLE / 角度 ±3°				PART NAME / 品名							
				SERIES 8071 PLUG ASSY ST PRESS FIT WITH POLARIZING KEY (LONG TAIL)							
DRAWN L1	DESIGNED M. YOSHIDA	CHECKED Y. SHIROYAMA	APPROVED H. TAGUCHI	PART NO. / 型番							
				17 8071 075 048 XXX P							
				DWG NO. / 図番				SHEET/REV			
				BJS 8071273				1/1 A			